

苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于投资片式多层陶瓷电容器项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：片式多层陶瓷电容器项目。
- 投资金额：项目总投资为 112,435.73 万元。
- 资金来源：自有资金以及自筹资金。
- 相关风险提示：
 - 1、本次投资的项目需经公司股东大会审议通过后生效。投资项目是否能够实施尚存在不确定性，如因经营、原材料、市场等方面因素的影响，项目可能存在延期、变更或终止的风险。
 - 2、项目投资资金来源部分为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化，如影响项目实施进度，将不利于公司未来业务的持续发展。
 - 3、拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

一、 对外投资概述

（一） 对外投资的基本情况

为了扩充苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）类半导体领域中电子陶瓷的产品品类，并满足公司在 MLCC 领域的订单需求，提升公司市场地位，公司的全资子公司池州昀冢电子科技有限公司（以下简称“池州昀冢”）拟投资建设片式多层陶瓷电容器项目（以下简称“MLCC 项目”），项目总投资为 112,435.73

万元，项目分两期投资，第一期计划投资为 62,479.64 万元，第二期计划投资为 49,956.09 万元。项目实施地点为安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区。实施本项目的资金来源主要为池州昀冢自有资金以及向银行申请授信额度。池州昀冢为本项目的实施主体，池州昀冢主营电子元器件的制造和销售，研发和制造汽车电子、陶瓷基板相关领域所需的精密电子零部件。

（二） 审批程序

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》，表决结果为：赞成票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。公司董事陆殷华对该议案投反对票，反对理由主要为：公司作为拟投资项目所属行业新进入者，在新产品的研发、客户拓展等方面将面临激烈的市场竞争，存在较大的市场风险；拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出以及项目产生的亏损对公司的财务影响较大；拟投资项目存在相应技术储备不完善、研发体系不可靠、相应的人才储备不足的风险。

董事会授权管理层相关人员负责本次投资项目的后续相关实施事宜，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第一届监事会第十次会议审议通过《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》，表决结果为：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、 实施主体概况

（一） 实施主体基本信息

企业名称	池州昀冢电子科技有限公司
成立日期	2020 年 12 月 2 日
注册资本	15500 万元

经营范围	电子产品及配件、塑料制品、电子元器件、其他电子元件、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、机电设备、五金机电、金属材料、模具的研发、生产、制造、销售；工艺品、生活日用品销售；电子产品技术咨询服务；从事自营货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止出口的货物及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人	王宾
股权结构	公司 100%持股

（二）池州昀冢的主要财务状况

(三) 项目	池州昀冢	
	2020/12/31 2020 年度	2021/03/31 2021 一季度
资产总额（元）	5,000,171.66	4,905,262.22
负债总额（元）	8.58	-883.84
资产净额（元）	5,000,163.08	4,904,541.46
营业收入（元）	0	0
净利润（元）	163.08	-93,853.94
扣除非经常性损益后的净利润（元）	163.08	-93,853.94

注：2020 年年度数据已经天衡会计师事务所审计，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日数据未经审计。

二、项目概况

1、本项目实施主体为池州昀冢电子科技有限公司，拟在安徽省池州市投资建设片式多层陶瓷电容器生产基地，对已建成厂房进行高标准洁净度装修。目前，池州昀冢已从池州市自然资源和规划局取得宗地编号为 H15 地块的土地，宗地总面积为 100,534 平方米。项目将购置国内外先进的自动化生产设备，引进行业内人才，建设人才队伍，满足公司在片式多层陶瓷电容器领域的订单需求，提升公司市场地位。同时，公司为响应国家“低碳环保、节能减排”的号召，在已建设完成的厂房楼顶，铺设光伏发电设备，满足本项目部分用电需求。项目达产年公司将实现年产 720 亿只片式多层陶瓷电容器的产能目标。

项目总投资为 112,435.73 万元，建设期限为 36 个月，前 18 个月为第一期建设，计划投资 62,479.64 万元，后 18 个月为第二期建设，计划投资 49,956.09 万

元。

2、项目的工程建设周期计划分以下阶段实施完成：可行性研究、初步规划与设计、建设装修、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运行。

3、本项目拟对建筑面积为 7,953.69 平方米的厂房进行装修，以达到片式多层陶瓷电容器生产所需的高标准洁净度要求；

4、购置层叠机、印刷机、烧结炉、流延机、电测机、研磨机、均质搅拌机、粘附线、烧附线、电镀线等国内外先进的生产设备；

三、 对外投资的必要性和可行性分析

（一）必要性分析

1、顺应“进口替代”发展趋势，推动 MLCC 产品国产化进程

根据中国电子元件协会统计数据显示，我国目前 MLCC 整体国产化率不足 4%，未来进口替代空间十分广阔。本项目的实施将有利于公司顺应“进口替代”行业发展趋势，从而更好的把握行业发展机遇，进一步提升公司的市场份额。通过本项目的建设，公司将全面提高 MLCC 相关产品的生产规模，实现 MLCC 相关产品的批量化、规模化生产，为行业整体的国产化进程提供可靠助力。

2、优化公司业务结构，形成新的利润增长点

近年来随着我国精密电子零部件产业的持续发展与技术水平的持续提升，行业竞争日趋激烈。基于产品多样性与抗风险能力等因素综合考虑，公司打造了“深耕光学领域，向多产业扩张”的战略布局，即以目前的光学镜片、音圈马达领域为基础，持续向电子陶瓷基板、陶瓷电容、汽车电子、“3C 电子”等为代表的多个产业进行业务拓展。

公司为了强化自身生产研发技术，抢占 MLCC 领域的市场份额，有必要对现有的产品结构进行优化与调整。本项目的实施有利于改善公司业务结构，推动公司向电子元器件、电子陶瓷基板以及陶瓷电容等国内新兴产业进行深度挖掘与发展，形成新的利润增长点。

（二）可行性分析

1、广阔的市场前景为本项目的实施提供产能消化基础

随着电子信息产业的迅速发展，电子信息产品更新换代速度较快，不断朝着“轻、薄、短、小”的方向发展，相应地，以电容器为代表的常用电子元件也不断发展变化。普通电容器介质损耗较大，电容温度系数选择范围小，随着电子陶瓷的发展，以陶瓷电容为代表的体积小、高频特性好、寿命长、电压范围大的电子元器件应运而生。陶瓷电容器可以分为单层陶瓷电容器（SLCC）、多层陶瓷电容器（MLCC）和引线式多层陶瓷电容。多层陶瓷电容器（MLCC）拥有体积小、比容大、寿命长、高频使用时损失率低、可靠性高等优点，在电子信息产品不断更新迭代的趋势下，其成本和性能都占据一定优势，目前已经成为应用最普遍的陶瓷电容产品，广泛应用于消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等其他工业领域。

中国 MLCC 消费量庞大，具有广阔的市场发展空间。根据中国电子元件行业协会发布的数据，2016年中国MLCC行业市场规模为257亿元，2020年达到554亿元，年均复合增长率达到21.17%。

广阔的市场空间及应用场景为本项目的产能消化奠定了良好的市场基础，有利于顺利消化项目产能，提高公司产品的市场渗透率，从而提升公司在行业的地位，实现未来战略发展目标。

2、公司成熟的管理团队为本项目的实施提供管理支持

管理团队是推动企业发展和创新的重要力量，其作用关系着企业的当前业绩和今后的发展。充分发挥管理团队的优势，有利于企业不断开拓创新，实现可持续发展。

公司管理团队拥有丰富的精密电子零部件制造行业从业经验，在设备选型、材料性能测试、技术水平和生产管理模式等方面积累了相对完善和深入的经验，从技术研发、采购供应、生产制造、售后服务、人力资源等方面形成了与公司持续发展相匹配的成熟管理模式，保证公司各项业务的高效运转和持续经营。基于对精密电子零部件制造行业的深刻了解，公司管理团队能够准确把握行业的发展动态，结合公司的实际情况、行业发展水平和市场需求，制定适合公司长远发展的战略规划，对公司的研发、生产、营销、投融资等经营管理进行合理决策并落地实施。

公司管理团队在建立健全公司体系架构、保证公司稳健发展的同时，具备合理

把控项目计划、项目成本控制、项目质量管理以及项目进度把控的能力，能够为本项目的实施提供管理支持。

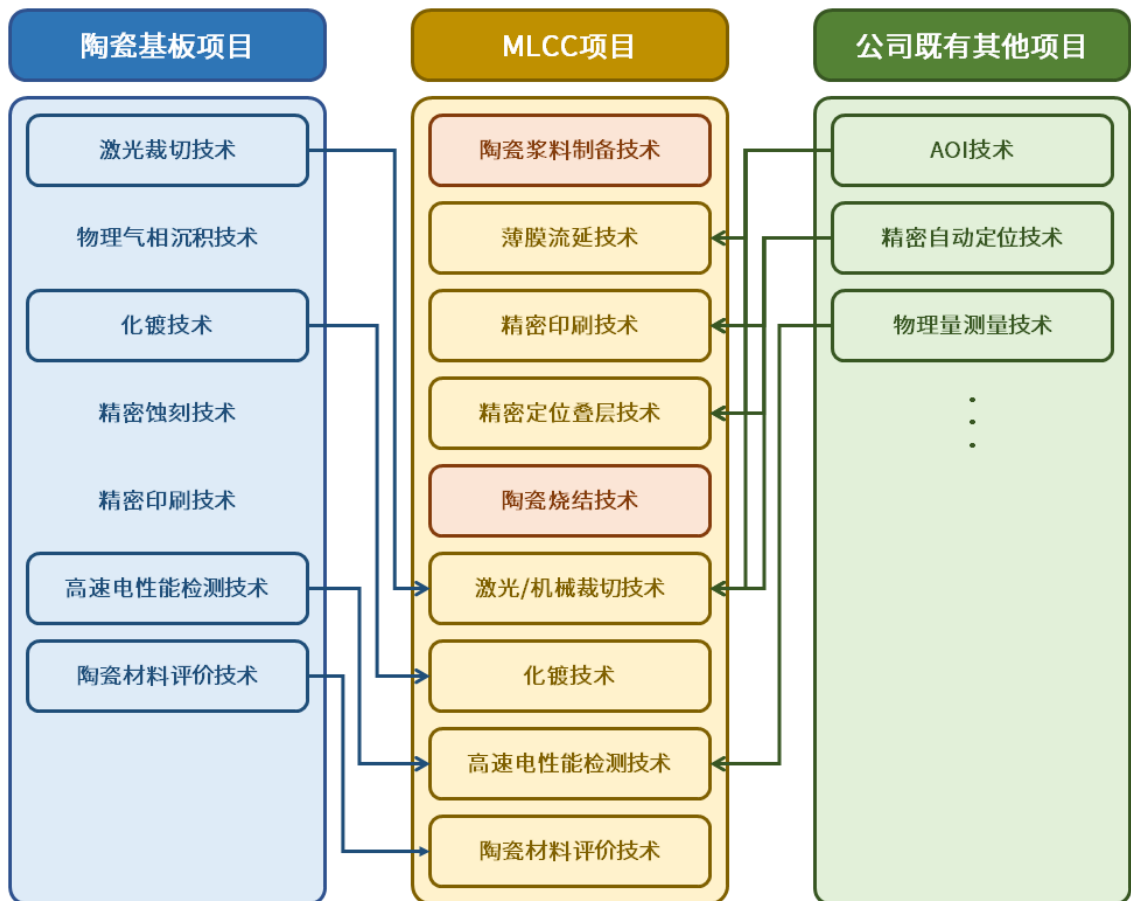
3、丰富的产业经验为本项目的实施提供有力保障

经过多年的发展和实践，公司已具备丰富的自动化设备研制经验、完善的质量管理体系和强大的市场开拓能力，可迅速实现对新产品生产流程进行优化和质量管控，并为新产品产能快速消化提供基础保障。在质量管理体系方面，公司制定的《质量手册》，明确了所有产品的生产流程及质量标准，确保公司为客户提供零缺陷的产品和服务。在市场开拓方面，公司已组建了一支以营销和服务为导向的营销管理团队，具有丰富的市场营销经验，公司强大的市场开拓能力，为本项目产品产能的消化提供强有力支持。

未来随着本项目的投产，公司对生产工艺环节升级的需求会不断增多，产品质量管理难度也会不断增大，公司将继续执行全面的品质管控，汲取以往的设备研制、质量管理经验，为本项目的顺利实施提供经验支持。同时，随着公司在片式多层陶瓷电容器产品产能的增加，公司将继续招募行业内营销人才，完善市场营销团队，为产品产能消化提供基础保障。

4、技术保障

MLCC 项目是公司在电子陶瓷应用领域的又一计划性拓展。公司与 2019 年年中开始布局电子陶瓷材料制备及其应用的相关领域，2020 年陶瓷基板制备项目成功量产，MLCC 项目也完成了前期论证开始实质性推进。公司专门成立了结合产品技术、工艺技术、设备技术及管理人员构成的项目组，计划由长期积累的工艺装备技术与招募的专业产品技术团队相互配合，以原有成熟制备技术为基础，导入世界先进设备并结合自身工艺需求进行适用性改造，以期打造出具备公司技术特点的高竞争力产品。公司现有陶瓷基板项目及其他项目中积累的诸如激光加工技术、表面处理技术、物理量测量技术及材料评价技术等均可在此次 MLCC 项目中得以运用并成为今后在竞争中差异化的关键点。另外，MLCC 项目亦计划引入陶瓷浆料制备及烧结等技术，作为公司长期发展战略的一部分，使得公司在电子陶瓷领域的产业链布局更趋完备，为中国在相关产业技术领域突破国外技术垄断做出贡献。公司已有技术在 MLCC 项目中的运用详见下图：



主要技术关联性分析表

四、 对外投资对上市公司的影响

本项目的建设有利于公司把握片式多层陶瓷电容器的发展机会，扩充公司产品结构，取得市场先发优势。同时也有利于增强公司的市场竞争力和应对风险的能力。

五、 本次对外投资的风险

（一） 审批风险

本次投资的项目需经公司股东大会审议通过后生效，投资项目是否能够实施尚存在不确定性。

（二） 财务风险

本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出。拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

（三） 资金筹措风险

项目投资资金来源部分为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化，如影响项目实施进度，将不利于公司未来业务的持续发展。

（四） 经营风险

本项目实施后，公司的生产管理范围将进一步扩大，组织结构和管理体系将不断扩充，公司在经营决策、资源整合、研发管理、人员管理等方面将面临更多的挑战，风险控制的难度大为增加。若公司现有的内部控制体系、技术人才的引进及培养、管理架构、管理人员素质、管理方式等无法适应公司规模迅速扩张，各部门的工作无法对现有的规模做出相应的协调调整，将会产生管理上的风险，阻碍公司的经营和未来可持续发展。

（五） 市场竞争风险

近年来，轨道交通、智能电网、新能源等行业迅速发展，电子设备行业智能化和互联网化已成为趋势，MLCC作为基础电子元件，市场空间十分广阔，行业内企业纷纷加大投入，市场竞争较为激烈。在国际知名企业占据高端市场份额的当下，中低端市场的竞争也尤为激烈。行业内不断有新兴公司崛起，加剧竞争。如果公司不能通过加大资金投入，持续提高技术工艺水平、提升产能水平、拓展市场渠道来积极应对新型市场需求，则在与国内外企业的市场竞争中将处于不利地位。

（六） 原材料价格波动风险

MLCC上游生产成本包括原材料成本、人工成本以及制造费用，其中原材料成本占比最大。MLCC主要原材料为陶瓷粉末和电极材料，故而，原材料价格的波动将对公司的生产成本产生直接影响。本项目实施后，公司 MLCC 产量将不断增加，若原材料价格波动剧烈或出现明显的上升趋势，且公司不能及时采取措施消化原材料价格波动带来的负面影响，将有可能导致公司的毛利率水平下降或产品价格被迫提升，不利于公司的稳定经营。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

董事会

2021年8月11日